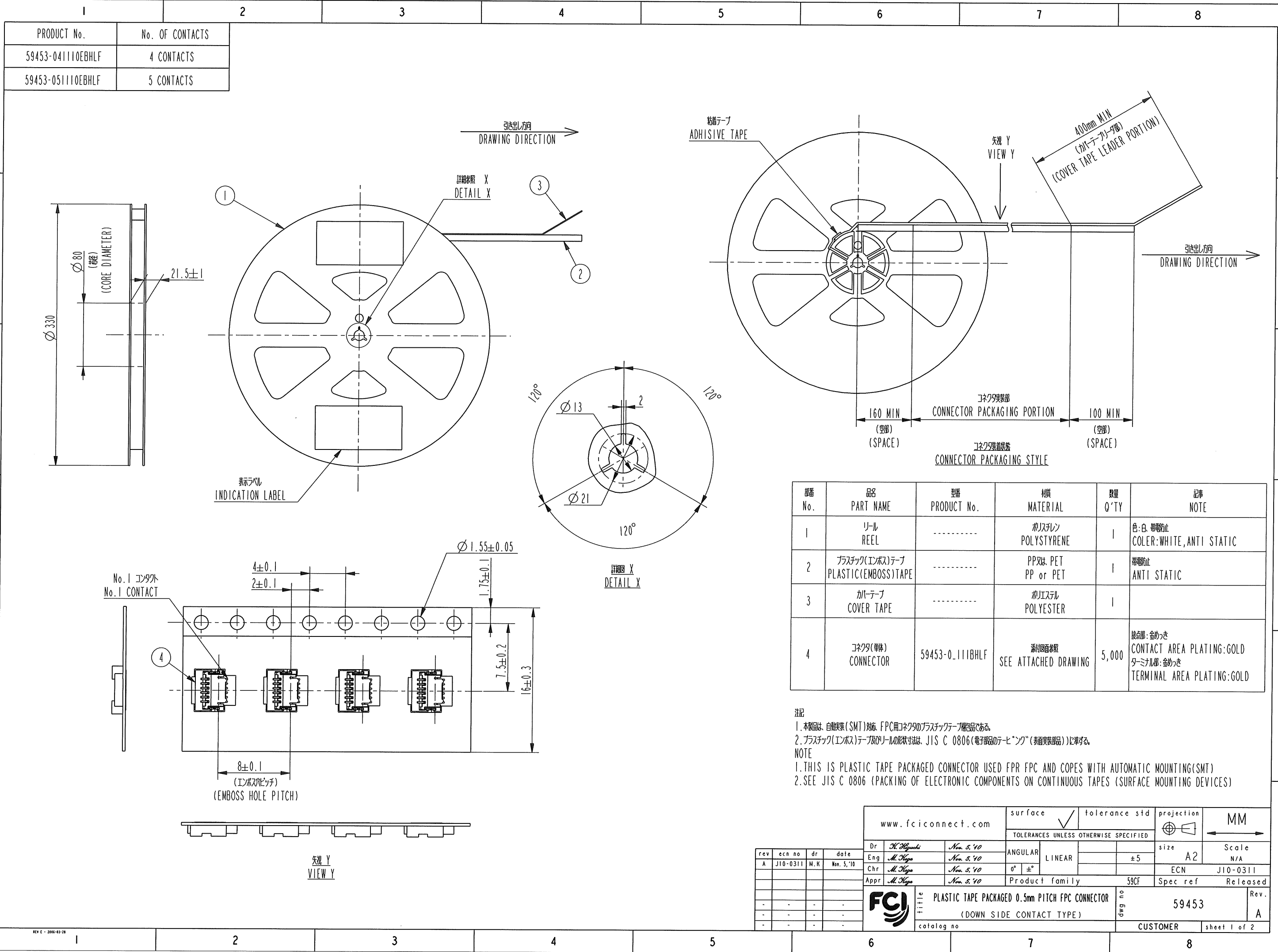
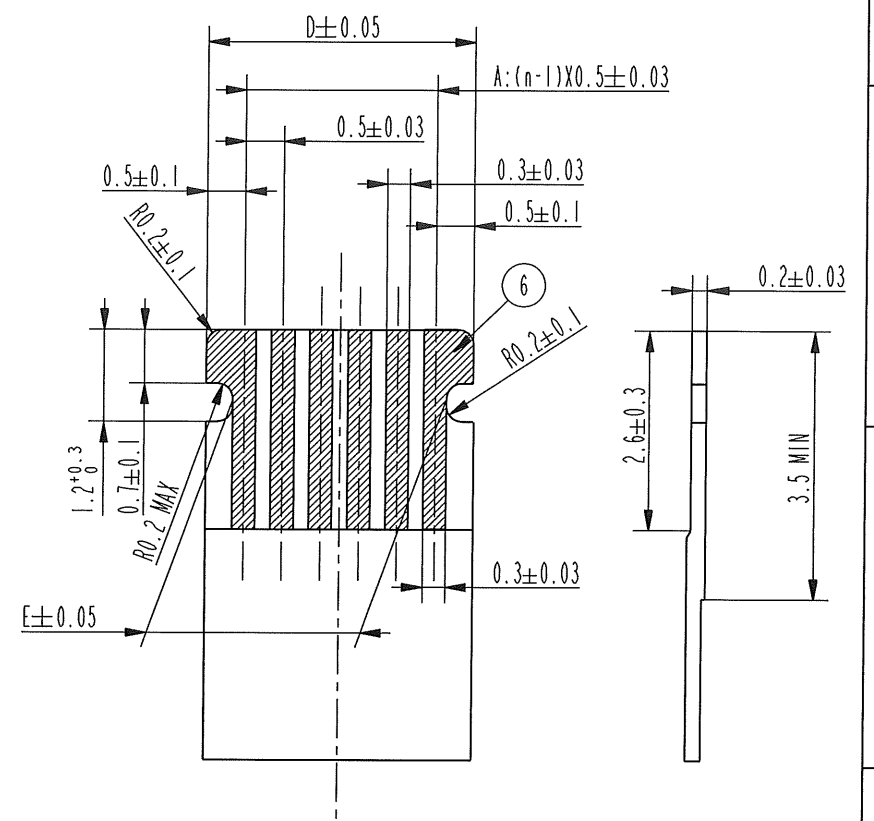
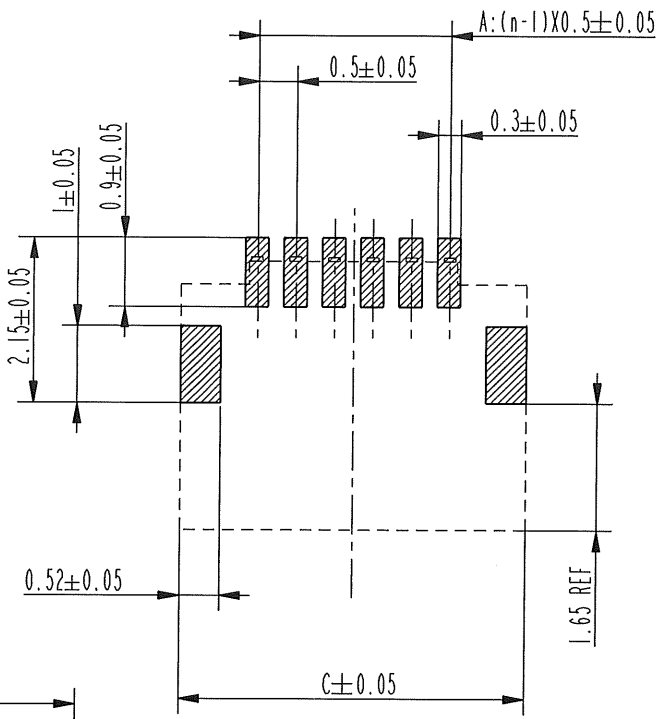
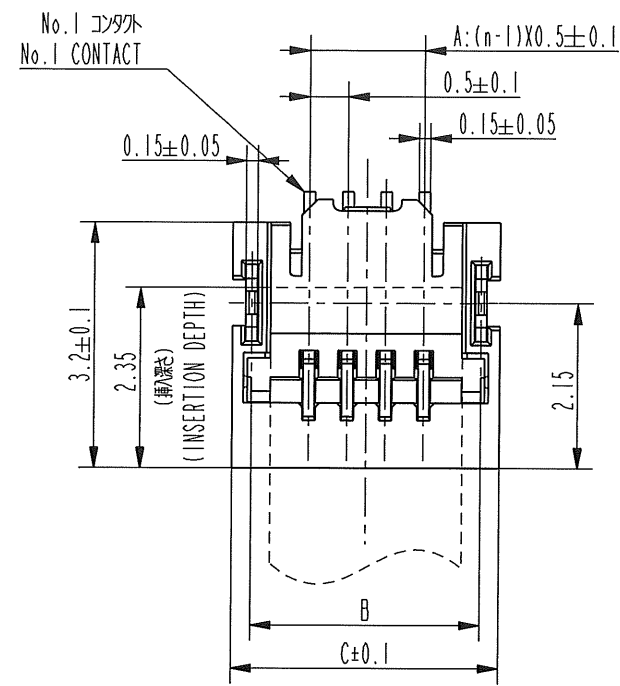




推奨基板パターン図
RECOMMENDED PCB LAYOUT

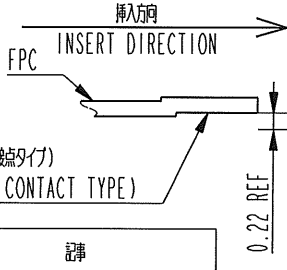
推奨FPC寸法
RECOMMENDED FPC



CONNECTOR PARTS LIST

部品番号 No.	部品名 PART NAME	材料 MATERIAL	数量 Q'TY	記事 NOTE
1	ハウジング HOUSING	ガラス繊維入り耐熱樹脂 UL94V-0 GLASS FILLED THERMOPLASTIC RESIN	1	色:黒, ハロゲンフリー COLOR:BLACK, HALOGEN FREE
2	アクチュエータ ACTUATOR	ガラス繊維入り耐熱樹脂 GLASS FILLED THERMOPLASTIC RESIN	1	色:黒, ハロゲンフリー COLOR:BLACK, HALOGEN FREE
3	コンタクト CONTACT	銅合金 COPPER ALLOY	n	接点部:金めっき CONTACT AREA PLATING:GOLD 端子部:金めっき TERMINAL AREA PLATING:GOLD
4	補強金具 FIXING TAB	黄銅 BRASS	2	めっき:錫めっき(鉛フリー) PLATING:TIN(LEAD FREE)

注記/NOTE
1. コントクト、補強金具の平坦度は0.1以内
1.COPLANARITY FOR CONTACT TERMINAL AND FIXING TAB MUST BE WITHIN 0.1mm.
2. 本製品は、GS-22-008に記載されたヨーロッパ指令と他国の規制に適合しています。
2.THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.



PRODUCT No. AND DIMENSIONS

PRODUCT No. (Not emboss packaging)	DIMENSIONS				
	A	B	C	D	E
59453-0411BHLF(4 CONTACTS)	1.5	3.0	3.5	2.5	1.8
59453-0511BHLF(5 CONTACTS)	2.0	3.5	4.0	3.0	2.3

FPC PARTS LIST

部品番号 No.	品名 PART NAME	材質 MATERIAL	記事 NOTE
5	ベースフィルム BASE FILM	ポリイミド POLYIMIDE	
6	導体 CONDUCTOR	銅箔 金めっき 0.1μm以上 COPPER FOIL(PLATING:GOLD 0.1μm)	
7	オーバーレイ OVER LAY	ポリイミド POLYIMIDE	
8	補強板 SUPPORTING TAPE	ポリイミド POLYIMIDE	

注記
熱硬化接着剤を使用し、接合方式は熱圧着とする。
NOTE
ADHISIVE METHOD OF SUPPORTING TAPE SHALL BE HEAT CRIMPING METHOD AND THERMOSETTING ADHISIVE SHALL BE USED

www.fciconnect.com				surface	tolerance std	projection	MM
				TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			
Dr	K. Higuchi	Nov. 5, '10		ANGULAR	LINEAR	size	Scale
Eng	M. Koga	Nov. 5, '10				A2	N/A
Chr	M. Koga	Nov. 5, '10		0°	±°	ECN	J10-0311
Appr	M. Koga	Nov. 5, '10		Product family		59CF	Released
FCI				title		59453	
				PLASTIC TAPE PACKAGED 0.5mm PITCH FPC CONNECTOR (DOWN SIDE CONTACT TYPE)		Rev. A	
				catalog no		CUSTOMER sheet 2 of 2	